

## 11. ESD-FORUM

1. – 2. Dezember 2009  
Holiday Inn Berlin City-West, Berlin

### \*\*\* ANKÜNDIGUNG und CALL FOR PAPERS \*\*\*

Die Tagung befaßt sich mit der Auswirkung elektrostatischer Ladungen auf die Mikroelektronik. Das Forum stellt eine Diskussionsplattform für die Betroffenen in der europäischen Industrie und Forschung dar. Es soll helfen, für die durch ESD verursachten Probleme neue Lösungen zu finden sowie den Austausch von Informationen zu fördern.

#### Die Beiträge sollen folgende Themen behandeln:

##### ESD-Test an Bauelementen

- Testmethoden und -normen
- Korrelation verschiedener Testmethoden
- Meßtechnik und Testgeräte
- Testsimulation

##### Empfindlichkeit von Bauelementen gegenüber elektrostatischen Feldern und ESD

- Testergebnisse
- Felddausfälle
- Schutzstrukturen
- Neue Phänomene

##### Fehlermechanismen

- Physikalische Modelle der ESD-Schädigung
- Simulation der Degradation
- Analyse von ESD-Fehlern

##### Testmethodik

- Vergleich zwischen On-Wafer und Gehäusen basierenden ESD-Testmethoden
- Beschleunigung von ESD-Testverfahren von „High-Pin-Count“ Bauelementen
- Multichip-Package-ESD-Test

##### Schutzmaterialien

- Testmethoden und -ergebnisse
- Neue Materialien

##### Vorsichtsmaßnahmen

- ESD-Schutzprogramme
- Verpackung, Handhabung und Transport von ESD-empfindlichen Bauelementen

##### ESD-Test auf Systemebene

- Testmethoden (IEC 61000-4-2)
- ESD-Pistolen, Kalibrierung
- Abgrenzung zum ESD-Test an Bauelementen
- Feldprobleme

#### Konferenzsprache

Schriftliche Beiträge, Vortrag und Diskussion können in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Alle angenommenen Beiträge werden in einem Tagungsband – ESD-Forum – veröffentlicht.

#### Einsendung

Interessierte Autoren senden ihren Beitrag per E-Mail an:

Hella KGaA Hueck & Co.  
Dipl.-Ing. Jürgen Higgen  
Haupt-ESD-Ingenieur/Chief-ESD-Engineer  
Technischer Service/Electro-Magnetic-Compatibility/GE-TE  
Beckumer Straße 130  
59552 Lippstadt/Germany  
Tel. (+49) 0 29 41/38 - 32272  
Fax (+49) 0 29 41/38 - 47 - 32272  
E-Mail juergen.higgen@hella.de

#### Termine

- |                  |  |
|------------------|--|
| 26. Juni 2009    | Eingang einer Kurzfassung, ca. 500 Worte                     |
| 14. August 2009  | Benachrichtigung der Autoren über die Annahme ihres Beitrags |
| 23. Oktober 2009 | Eingang der vollständigen Beiträge                           |

#### Auszeichnung

Der beste Beitrag wird vom Technischen Programmkomitee prämiert.

#### Tagungsleiter

Armin Gottschalk

#### Vorsitzender des Technischen Programmkomitees

Jürgen Higgen

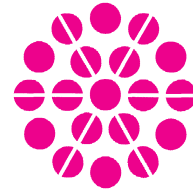
#### Technisches Programmkomitee

Mitglieder des Fach-Kreises des ESD FORUM e.V.

#### Organisation

Interessenten für Auslagen von Informationsmaterial wenden sich an

Armin Gottschalk  
c/o RELNETyX AG  
Meisenweg 33, D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel. 07 11/693 97 80  
Fax 07 11/693 97 71  
Mobil 01 78/785 93 27  
E-Mail armin.gottschalk@relnetyx.com



## 11. ESD-FORUM

December 1<sup>st</sup> – 2<sup>nd</sup>, 2009  
Holiday Inn Berlin City-West, Berlin

### \*\*\* ANNOUNCEMENT and CALL FOR PAPERS \*\*\*

Subject of the conference are electrostatic effects on solid state electronics. The intention is to support the discussion between the scientific and industrial communities within Europe in order to improve possible solutions for ESD related problems for any application of electronic components. The ESD Forum will also present current available information.

#### Submitted papers should cover the following fields:

##### Device Testing

- Test methods and standards
- Correlation of different test methods
- Tester evaluation
- Test simulation

##### Susceptibility of Devices against Static Fields and ESD

- Test results
- Field failures
- Protective structures
- New phenomena

##### Failure Mechanisms

- Modeling and physics of damage
- Simulation of degradation
- Analysis of device failures

##### Test Methods

- Comparison of On-Wafer and Packaged based ESD-Test-Methods
- Acceleration of ESD-Test-Procedures of "High-Pin-Count" Devices
- Multichip-Package-ESD-Test

##### Protective Materials

- Test methods and results
- New material

##### Precautionary Methods

- ESD control programs
- Packaging, transport and handling of ESD sensitive devices

##### System Level ESD Test

- Test Methods (IEC 61000-4-2)
- ESD Guns, Calibration
- Delimitation to ESD Device Test
- Problems in the field

#### Conference Language

German or English language may be used for printed materials, presentation and discussion.

All accepted papers will be published in the "ESD Forum" conference proceedings.

#### Submission Guidelines

Extended abstracts of 500 words should be sent by e-mail to:

Hella KGaA Hueck & Co.  
Dipl.-Ing. Jürgen Higgen  
Haupt-ESD-Ingenieur/Chief-ESD-Engineer  
Technischer Service/Electro-Magnetic-Compatibility/GE-TE  
Beckumer Straße 130  
59552 Lippstadt/Germany  
Phone (+49) 0 29 41/38 - 32272  
Fax (+49) 0 29 41/38 - 47 - 32272  
e-mail juergen.higgen@hella.de

#### Dead Lines

June 26<sup>th</sup>, 2009 Submission of extended abstracts  
August 14<sup>th</sup>, 2009 Notification of accepted papers  
October 23<sup>rd</sup>, 2009 Submission of full papers

#### Award

The best paper will be awarded by the Technical Program Committee.

#### Chairman

Armin Gottschalk

#### Chairman Technical Program Committee

Jürgen Higgen

#### Technical Program Committee

Members of the ESD FORUM e.V.

#### Organisation

Companies interested in presenting literature are requested to contact

Armin Gottschalk  
c/o RELNETyX AG  
Meisenweg 33, D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Phone +49 (0) 7 11/6 93 97 80  
Fax +49 (0) 7 11/6 93 97 71  
Cell +49 (0) 1 78/7 85 93 27  
e-mail armin.gottschalk@relnetyx.com